

**POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA**



**URZĄD
PATENTOWY
PRL**

O P I S P A T E N T O W Y P A T E N T U T Y M C Z A S O W E G O

81736

Patent tymczasowy dodatkowy
do patentu _____

Zgłoszono: 01.09.1971 (P. 150289)

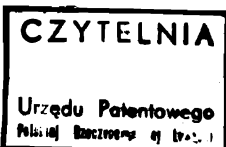
Pierwszeństwo: _____

Zgłoszenie ogłoszono: 30.05.1973

Opis patentowy opublikowano: 15.10.1975

Kl. 71a,9/14

MKP A43b 9/14



Twórcy wynalazku: Maksymilian Machaliński, Zygmunt Jakowienko, Stanisław Pielichowski,
Edmund Maćkiewicz

Uprawniony z patentu tymczasowego: Warszawskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Syrena”
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zakład Obuwia,
Mława (Polska)

Sposób montażu obuwia bezpodpodeszwowego

Wynalazek dotyczy nowej technologii wytwarzania obuwia w części procesu technologicznego dotyczącej formowania cholewek na kopycie. Znane systemy montażu polegają na formowaniu cholewek na kopycie przez zaciąganie dolnych brzegów cholewek i w znany sposób ich przymocowywanie do brzegów podpodeszew. Podpodeszwy w podanych systemach stanowią fundament obuwia i są jego niezbędną częścią składową.

Sposób montażu bezpodpodeszwowy, który jest przedmiotem wynalazku, polegający na formowaniu cholewek na kopycie, przebiega następująco: cholewkę składającą się z części górnej okrywającej wierzch stopy i części dolnej przylegającej do podszewkowej strony stopy, zszywa się na bokach w części śródstopia i przedstopia, następnie po nałożeniu cholewki na kopyto łączy się za pomocą nici opłotowych obie części cholewki w części czubka, a następnie w części pięty, przy czym łączenia części cholewki dokonuje się nieco powyżej krawędzi ograniczającej powierzchnię podszewkowej strony stopy.

Powyższy sposób montażu eliminuje całkowicie stosowanie podpodeszew nie obniżając wartości użytkowej obuwia, a poprawia jego walory użytkowe i higieniczne. Wyeliminowany jest również proces ówiekowania dla uformowania cholewki na kopycie. Obuwie bez podpodeszwy jest leższe i bardziej elastyczne.

Na załączonym rysunku fig. 1 przedstawia przednią część obuwia wykonanego systemem montażu według wynalazku w przekroju poprzecznym oraz fig. 2 — obuwie z wycięciami w części czubka i pięty w widoku z boku. Górną część cholewki 2 okrywającą wierzch stopy zszywa się szwem zwartym 1 w części śródstopia i przedstopia z dolną częścią cholewki 3 przylegającą do strony podszewkowej stopy, a po zszyciu nakłada się na kopyto, po nałożeniu łączy się obie części za pomocą nici opłotowych 4 w części czubka, a następnie w części pięty, przy czym łączenie części cholewki odbywa się nieco powyżej krawędzi ograniczającej powierzchnię podszewkową strony stopy. Dla podniesienia wartości użytkowej obuwia na dolną część cholewki 3 od zewnątrz nakleja się podszewę 5 z obcasem klinowym 6, przy czym obcas przyklejony jest jedną powierzchnią do podszewy, a drugą do dolnej części cholewki. Po wyjęciu kopyta z cholewki, dla podniesienia wygody w użytkowaniu, na dolną część cholewki od wewnątrz nakleja się wyściółkę złożoną z jednej warstwy miękkiej skóry podszewkowej 7 i jednej warstwy pianki poliuretanowej 8. Przyklejanie podszew, obcasów i wykończenie obuwia odbywa się znanymi sposobami.

Stroną dodatnią sposobu montażu obuwia bezpodpodeszwowego jest jego duża elastyczność, wygoda w użytkowaniu oraz mała pracochłonność. Z uwagi na prostą konstrukcję i nieskomplikowany proces montażu,

obuwie może być wytwarzane przez osoby przyuczone i w warunkach produkcji nakładczej. Obuwie jest szczególnie przydatne dla celów turystyki pieszej i dla kierowców.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób montażu obuwia bezpodpodeszwowego, polegający na formowaniu cholewek na kopycie, znamienny tym, że cholewkę składającą się z części górnej okrywającej wierzch stopy i części dolnej przylegającej do podszewowej strony stopy, zszywa się na bokach w części śródstopia i przedstopia, następnie po nałożeniu cholewki na kopyto łączy się za pomocą nici oplotowych obie części cholewki w części czubka, a następnie w części pięty, przy czym łączenia części cholewki dokonuje się nieco powyżej krawędzi ograniczającej powierzchnię podszewowej strony stopy.

